



Produktübersicht

Die individuell gefertigten Abschirm Dosen werden im Fotoätzverfahren oder durch Pressen von dünnem Blech hergestellt, das anschließend gefaltet und gelötet bzw. mit Laschen versehen wird, um die Abschirmdose zu bilden. Die Dosen haben einen abnehmbaren oder fest eingebauten Deckel und werden auf einer Leiterplatte montiert, um einzelne oder mehrere Bauteile abzudecken und zugleich eine ausgezeichnete EMI/RFI-Abschirmung sicherzustellen.

Anwendungen

Die Leiterplatten-Abschirm Dosen bieten eine effektive Lösung, wenn es um die Isolierung von Leiterplattenkomponenten geht. Sie können einfach oder mehrfach unterteilt sein, um die Bauteile auf einer Leiterplatte abzuschirmen.

Lieferformen

Die maßgeschneiderten Abschirm Dosen können schnell gefertigt und auf spezifische Anwendungen ausgerichtet werden. Zugleich bieten sie effektivere Lösungen als übliche Standardprodukte.

Das Fotoätzen ist ein flexibles Fertigungsverfahren und ermöglicht es, kostengünstige Produkte mit schnellen Durchlaufzeiten herzustellen.

Die Dosen können in Flachform mit geätzten Biegelinien zum Selbstformen bzw. fertig geformt geliefert werden.

Im Vergleich dazu ist das Stanzen und Pressen aufgrund der entstehenden Werkzeugkosten kostenintensiver. Hier liegt allerdings der Vorteil darin, dass eine große Stückzahl mit niedrigen Stückkosten gefertigt werden kann. Bei diesen Verfahren können die Dosen nur fertig geformt geliefert werden.

- Die Dosen können mit festen Deckeln oder abnehmbaren Fingerdeckeln für den Bauteilzugang hergestellt werden.
- Die Dosen sind mit Durchsteck- oder Oberflächenmontageoption erhältlich.

- Interne Trennwände können bei nahezu allen Ausführungen hinzugefügt werden.
- Die Deckel und Rahmen können mit Lüftungs- und Zugangsöffnungen versehen werden.
- Kleinere Dosen können mit Klebeband geliefert und für die automatische Bestückung aufgerollt werden.
- Es stehen zahlreiche Materialien und Oberflächenbeschichtungen zur Verfügung, einschließlich Nichteisenmetalle (z. B. Phosphorbronze und Berylliumkupfer) sowie Zinn-, Nickel- und Zinn/Blei-Beschichtungen.

Gestaltungsaspekte

Das für eine Anwendung geeignete Design wird durch Faktoren wie Größe, Volumen, Montageart, Zugänglichkeit der Bauteile etc. bestimmt. Aber auch die Materialauswahl sollte sehr sorgfältig erfolgen:

- Für Niederfrequenzanwendungen (z. B. Transformatoren, Spulen etc.) sollten hochpermeable Materialien wie Stahl oder Nichteisenmetalle verwendet werden.
- Für Hochfrequenzanwendungen (z. B. Mikroprozessoren, schnell schaltende Bauelemente, Schaltnetzteile) sollten Nichteisenmaterialien verwendet werden.

Fertigungskapazitäten

Kemtron verfügt über umfassende Erfahrungen in der Entwicklung, Herstellung sowie der Prüfung einer breiten Palette an Abschirmprodukten. Somit können wir unsere Kunden dabei unterstützen, die optimale Lösung für die entsprechenden Abschirmanforderungen zu finden.

Spezifikation

Die Abschirm Dosen werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Bitte setzen Sie sich mit unserem Vertrieb in Verbindung, damit wir Ihre konkreten Anforderungen besprechen können. Wir benötigen von Ihnen eine Zeichnung bzw. detaillierte Beschreibung, die Aufschluss über die Gesamtabmessungen, Materialauswahl, Beschichtung, Konfiguration der Durchsteck-/Oberflächen-montage, Anzahl, Toleranzen, Verpackung und spezielle Anforderungen gibt.

